
概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料之概覽。由於僅屬概要，故並無載列對閣下可能屬重要的所有資料。閣下在決定[編纂][編纂]前應細閱整份文件。任何投資均涉及風險。[編纂][編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下決定[編纂][編纂]前，須細閱該節全部內容。

概覽

我們是誰

我們是一家面向AI時代的領先獨立半導體存儲解決方案提供商，擁有業內稀缺的「主控芯片x創新存儲方案設計x先進封測」全棧技術能力。作為業內少數具備該等能力的公司之一，我們將NAND及DRAM晶圓轉化為多樣化的存儲解決方案，以精準契合AI時代對應用持續演變的需求。我們深刻洞察AI技術革命對數據處理和存儲帶來的爆發式增長，構築了「研發封測一體化」經營模式，該模式將產品研發與先進封測無縫整合，從而實現卓越的研發效率、產品定製能力及品質保證。依託該模式，我們不僅能向智能移動及AI新興端側、PC及企業級存儲、智能汽車及行業領域的全球客戶提供全面、高性能、定製化的半導體存儲解決方案，更能精準把握AI轉型所催生的巨大增長機遇，以滿足其對密集數據交互、高容量及低功耗存儲解決方案的強勁需求。

我們在多個垂直領域佔據市場領先地位。我們的解決方案已服務於包括Meta、Google、小米、OPPO、vivo、榮耀、傳音、摩托羅拉、中興、TCL、惠普、聯想、宏碁、華碩、Positivo、比亞迪及長安等眾多全球知名客戶。我們與全球領先品牌的廣泛合作，彰顯了我們交付多樣化存儲解決方案的卓越能力，可精準契合各行業的多元技術需求。為鞏固我們的技術領先地位，我們持續加大對存儲介質分析、主控芯片設計、固件算法、超薄堆疊、晶圓級封裝及高速測試等領域的投入，以應對後摩爾時代對數據傳輸效率、功耗、可靠性及集成度方面不斷提高的要求。

我們已與全球領先的NAND和DRAM供應商及全球知名晶圓代工廠建立了穩固的長期戰略合作關係。通過與上游供應商的深度合作，我們拓展了存儲介質的應用邊界，並助力存儲產品行業的發展。此外，我們與上游供應商的緊密關係確保了NAND及DRAM的穩定供應，從而保障我們產品的穩定交付。

概 要

根據弗若斯特沙利文的資料，我們是全球唯一一家具備晶圓級封裝能力的獨立存儲解決方案提供商。於2024年，按相關收入計，我們是全球最大的擁有自主封裝製造的獨立存儲製造商。同年，按相關收入計，我們亦為全球最大的AI新興端側半導體存儲解決方案供應商，在各類AI端側應用領域處於領先地位，包括AI/AR眼鏡、AI智能手錶及AI學習機。隨著AI新興端側市場的快速增長，我們的市場領先地位及技術能力為我們的持續增長提供了堅實支撐。

下圖展示了我們的業務亮點。



附註：

* 就2024年相關收入方面。

概 要

我們的優勢

我們認為，我們的業務成功及市場領先地位乃基於以下主要優勢：

- 首創整合存儲研發封測一體化模式，服務AI時代存儲解決方案需求；
- 一體化生產與供應鏈體系，保障可靠交付；
- 拓展高性能產品組合，服務全球領先客戶；
- 全球化業務佈局，產業鏈夥伴緊密協同；及
- 遠見卓識的管理團隊和經驗豐富的工程師隊伍引領前沿研發。

我們的增長戰略

我們計劃實施以下策略，以鞏固及提升我們在行業中的領先地位：

- 全面擁抱AI，以全棧技術能力和創新解決方案全面服務「端 — 邊 — 雲」客戶；
- 推動全球化戰略，打造國際卓越存儲品牌；及
- 通過合作與併購推動戰略增長。

我們的業務模式

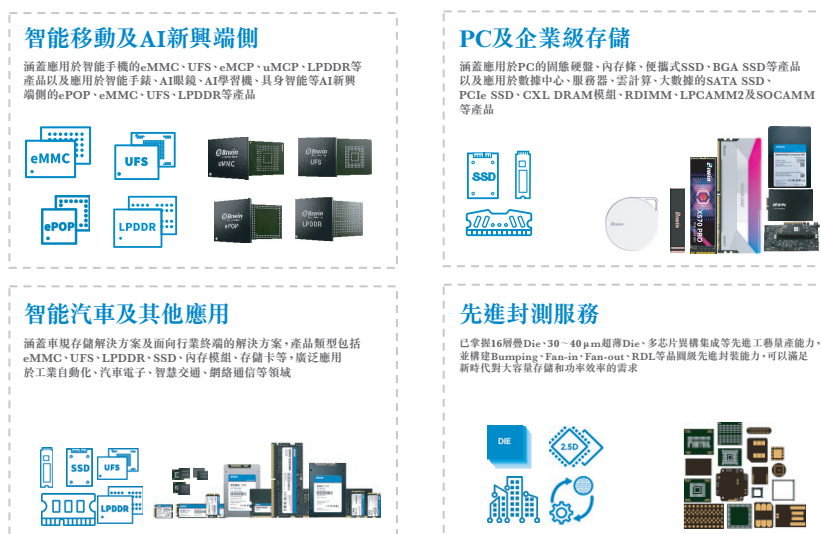
我們採用研發封測一體化模式運營，涵蓋存儲介質分析、主控芯片設計、固件算法開發、軟硬件創新以及先進封測。我們的研發封測一體化模式提高了研發效率，提升了定製能力，加強了品質保證，使我們能夠提供為AI時代構建的高性能、全面及定製化的解決方案。

概 要



我們的產品及服務

我們提供高性能的半導體存儲解決方案，覆蓋智能移動及AI新興端側、PC及企業級存儲、以及智能汽車及其他應用領域等多元應用場景。同時，依託我們一體化技術能力，我們亦為行業核心客戶提供先進封測服務。



- **智能移動與AI新興端側**。我們的智能移動與AI新興端側解決方案包括低功耗 DDR(LPDDR)、eMMC、UFS、ePOP、eMCP及uMCP等。該等解決方案已廣泛應用於智能手機、平板電腦、AI/AR眼鏡、智能手錶、AI學習機、具身智能及其他AI新興端側，以便在緊湊、低功耗的環境中為實時AI功能實現端側處理。我們的解決方案已獲Meta、Google、小米、OPPO、vivo、榮耀、傳音、摩托羅拉、中興、TCL、Positivo、Rokid及雷鳥創新等知名客戶採用。特別值得一提的是，

概 要

我們的ePOP解決方案憑藉其超薄緊湊設計、低功耗與高可靠性等突出優勢，通過了廣泛的市場驗證，高度契合AI新興端側的需求。

- **PC及企業級存儲**。我們的PC存儲解決方案包括SSD、DRAM模組、便攜式SSD(PSSD)及BGA SSD，廣泛應用於台式機、筆記本電腦及電競主機等終端，為日常任務及高性能計算提供快速、可靠的數據處理。我們為知名PC品牌提供用於預裝的存儲解決方案，同時提供我們自己的品牌產品，並獨家運營惠普、宏碁及Predator的品牌授權，以強化我們的後裝市場影響力。我們創新的Mini SSD產品榮獲《時代》週刊「2025年度最佳發明」之一，滿足了超薄輕巧設備的存儲需求。針對AI PC時代，我們的優質存儲解決方案具備更高數據傳輸效率、更大容量與更優能效，強力支持模型推理、實時處理等本地AI功能。此外，我們的企業級存儲解決方案包括SATA SSD、PCIe SSD、CXL DRAM模組、RDIMM、LPCAMM2及SOCAMM，主要部署於數據中心及服務器，為密集型數據處理及AI驅動的工作負載提供高容量、低延遲的存儲支持。我們的解決方案已通過頭部服務器廠商及知名互聯網公司的認可和採用。
- **智能汽車及其他應用**。我們的智能汽車及其他應用存儲解決方案包括車規級LPDDR、eMMC、UFS和存儲卡，以及用於其他工業領域的SSD和DRAM模組。該等解決方案為自動駕駛、智能座艙及實時導航等先進智能汽車功能提供了支持。我們的解決方案已通過數家國內領先汽車OEM廠商的嚴苛認證，並已成功實現大批量交付。憑藉自研主控芯片與先進封裝能力，我們的車規級解決方案能夠提供端到端數據保護，並已通過AEC-Q100車規級電子元件認證。
- **先進封測服務**。我們具備先進封裝工藝能力。依託該等技術，我們為半導體產業的戰略夥伴提供先進封裝服務，以應對AI時代的技術挑戰。與此同時，我們擁有全面的自主測試能力及業界領先設備。通過與自身存儲解決方案的高效協同，我們的先進封測服務可保障高性能、高可靠性的存儲解決方案的交付，同時嚴格恪守以IATF 16949為代表的國際質量標準，有效縮短產品上市週期，並為存儲解決方案的量產提供有力支持。

概 要

我們的半導體存儲解決方案分為DRAM解決方案(如LPDDR及DDR)、NAND Flash解決方案(如eMMC、UFS及SSD)以及多芯片封裝(MCP)解決方案(如uMCP、eMCP及ePOP)。

下表載列我們的主要產品類型及其應用場景：

產品類型	智能移動與AI新興端側	PC	企業級存儲	智能汽車及其他應用
NAND Flash	 eMMC UFS BGA SSD	 PC 預裝 SSD PC 消費級 SSD/PSSD	 企業級 SATA SSD 企業級 PCIe SSD	 車規級 eMMC 車規級 UFS 車規級 BGA SSD 工規級 SSD
DRAM	 LPDDR	 PC 預裝 內存條 PC 消費級 內存條	 企業級 RDIMM CXL DRAM 模組 LPCAMM2	 車規級 LPDDR 工規級 內存條
MCP	 eMCP uMCP ePOP			

下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的收入明細(按絕對金額及佔總收入的百分比)：

	截至12月31日止年度						截至6月30日止六個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元, 百分比除外)						(未經審計)			
智能移動及AI新興端側	1,756,059	58.8	1,181,945	32.9	3,710,234	55.4	1,870,413	54.4	1,683,009	43.0
PC及企業級存儲	676,950	22.7	1,766,489	49.2	2,041,436	30.5	1,095,137	31.8	1,365,233	34.9
智能汽車及其他應用	529,304	17.7	528,250	14.7	836,396	12.5	408,990	11.9	780,845	20.0
先進封測服務	23,380	0.8	114,068	3.2	107,119	1.6	66,240	1.9	83,250	2.1
總計	2,985,693	100.0	3,590,752	100.0	6,695,185	100.0	3,440,780	100.0	3,912,337	100.0

概 要

下表載列於往績記錄期間各半導體存儲解決方案類別的銷量(以GB計)及各解決方案每GB的平均售價：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
DRAM					
— 銷量(百萬GB)	37.2	68.0	82.0	50.6	68.0
— 平均售價(每GB人民幣元) .	21.3	10.5	14.8	14.8	14.2
NAND Flash					
— 銷量(百萬GB)	2,566.6	8,255.7	10,349.4	5,001.6	5,816.4
— 平均售價(每GB人民幣元) .	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4
MCP					
— 銷量(百萬GB)	111.5	142.4	322.3	159.9	198.1
— 平均售價 ⁽¹⁾ (每GB人民幣元)	3.9	2.8	2.7	2.7	2.4

附註：

(1) MCP的平均售價按來自MCP的收入除以MCP中嵌入的DRAM及NAND Flash的銷量計算。

我們的核心技術

在研發封測一體化模式下，我們已建立一整套核心技術，使我們能夠滿足AI轉型日益增長的要求。我們的技術能力涵蓋存儲介質分析、主控芯片設計、固件算法、先進封測領域，使我們成為少數能覆蓋存儲產品行業價值鏈所有關鍵步驟的公司之一。利用我們的核心技術，我們持續創新，在快速發展的應用規格下提供高可靠性和高性能的存儲解決方案。

概 要

我們的核心技術主要包括：

- **存儲介質分析**：存儲介質分析是高性能存儲解決方案的基礎。我們的存儲介質分析能夠實現性能優化，通過將存儲介質的物理特性與設計的應用場景相匹配，最大限度地提升每個晶圓的實用價值。此外，存儲介質分析的數據可用於主控芯片設計、固件算法優化和測試算法開發，既能提升研發效率，亦可增強存儲解決方案的可靠性和性能。
- **主控芯片設計**：主控芯片是用於SSD、eMMC和UFS的專用IC，管理存儲介質與處理器之間的數據操作，協調數據傳輸，最大限度地減少延遲並處理各種任務。我們的主控芯片設計能力增強了我們的整體競爭力，使我們能夠提供適合各種應用場景的定製化解決方案，並提高我們的研發效率。
- **固件算法**：我們的固件算法創建嵌入我們存儲解決方案的專用軟件指令，使其能高效管理數據、糾正錯誤和節省功耗，從而為智能設備、服務器和汽車系統提供更快速、更可靠的性能。
- **先進封測**：我們擁有的先進封裝技術，通過採用BGA、倒裝芯片及FOMS封裝技術等行業領先的多芯片堆疊技術，解決了應用中技術要求與原廠晶圓密度之間的差距。具體而言，我們的FOMS將扇出技術與多層存儲器芯片堆疊相結合，採用引線鍵合、凸塊和重佈線層(RDL)等工藝，提供大容量及超薄存儲解決方案。

研究及開發

我們以研發封測一體化模式運營，橫跨存儲介質分析、主控芯片設計、固件算法開發、軟硬件創新及先進封測。為保持技術優勢，我們與上游NAND及DRAM供應商溝通，拓展應用場景，推動存儲產品行業增長。

於往績記錄期間，我們於2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年6月30日止六個月的研發開支分別為人民幣126.4百萬元、人民幣250.0百萬元、人民幣447.4百萬元、人民幣210.3百萬元及人民幣272.9百萬元，佔各期間收入的4.2%、7.0%、6.7%、6.1%及7.0%。我們對創新的投入持續推動我們的增長。截至2025年6月30日，我們在中國內地擁有超過170項商標及超過390項註冊專利。

概 要

生產

高質量且可靠的生產對於半導體存儲解決方案提供商至關重要，確保產品質量一致、性能可靠及供應穩定，以滿足不同終端市場的嚴格需求。我們的研發封測一體化模式著重於生產流程、先進的封測，從而通過端到端控制與效率，應對半導體存儲器產品的關鍵生產階段。這種一體化方式令我們與其他業界同行與眾不同，憑藉專屬的生產設施，我們得以實現涵蓋全面的產品開發體系。

截至最後實際可行日期，我們在中國擁有兩個生產基地。下表載列截至2025年6月30日有關我們生產基地的資料。

生產基地	位置	面積 (平方米)	產能	投產年份
惠州生產基地	中國廣東省惠州市仲愷區陳江街道僑飛路25號	99,917 ⁽¹⁾	後道工藝生產階段	2021年
東莞生產基地	中國廣東省東莞市松山湖園區興業路6號	68,201 ⁽²⁾	晶圓級封裝	2026年

附註

- (1) 計量所有樓層累計樓面面積的建築面積。
- (2) 計量整幅地塊面積的地盤面積。

銷售及營銷

憑藉我們品牌的國際認可及廣泛的銷售渠道，我們在海外市場建立了顯著的市場版圖。於往績記錄期間，我們擁有的分銷網絡覆蓋60多個國家及地區，覆蓋美洲、東南亞及歐洲。

概 要

下表載列我們於所示期間按地理區域劃分的收入明細(以絕對金額及佔總收入的百分比列示)：

	2022年		截至12月31日止年度 2023年		2024年		截至6月30日止六個月 2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)									
	(未經審計)									
中國內地	1,178,770	39.5	2,042,525	56.9	3,369,468	50.3	1,731,721	50.3	2,007,940	51.3
其他國家或地區 ⁽¹⁾	1,806,923	60.5	1,548,227	43.1	3,325,717	49.7	1,709,059	49.7	1,904,397	48.7
總計	<u>2,985,693</u>	<u>100.0</u>	<u>3,590,752</u>	<u>100.0</u>	<u>6,695,185</u>	<u>100.0</u>	<u>3,440,780</u>	<u>100.0</u>	<u>3,912,337</u>	<u>100.0</u>

附註：

(1) 其他國家或地區主要包括來自中國香港、美洲、東南亞及歐洲的收入。

我們的產品通過直銷及分銷兩種方式銷售。我們保持靈活的銷售架構，能夠迅速應對客戶的特定需求及市場趨勢。這種方法讓我們能夠更好地契合客戶需求，優化供應鏈效率，並支持更廣泛的市場覆蓋。

下表載列我們於所示期間按銷售渠道劃分的收入明細(以絕對金額及佔總收入的百分比列示)：

	2022年		截至12月31日止年度 2023年		2024年		截至6月30日止六個月 2024年		2025年	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣千元，百分比除外)									
	(未經審計)									
直銷	687,090	23.0	1,524,550	42.5	3,246,364	48.5	1,594,010	46.3	1,762,764	45.1
分銷	2,298,603	77.0	2,066,202	57.5	3,448,821	51.5	1,846,770	53.7	2,149,573	54.9
總計	<u>2,985,693</u>	<u>100.0</u>	<u>3,590,752</u>	<u>100.0</u>	<u>6,695,185</u>	<u>100.0</u>	<u>3,440,780</u>	<u>100.0</u>	<u>3,912,337</u>	<u>100.0</u>

我們的客戶

我們的終端客戶主要包括行業領先的全球移動設備及PC製造商、數據中心及計算服務器提供商以及領先的汽車整車廠商。於往績記錄期間，我們五大客戶貢獻的收入分別佔我們於2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月總收入的39.6%、32.3%、46.7%及47.3%，而同期最大客戶分別佔我們總收入的10.4%、8.9%、17.2%及12.6%。

概 要

供應鏈管理

我們的供應商主要包括DRAM及NAND供應商。於往績記錄期間各年度／期間，我們從五大供應商的採購額分別為人民幣2,076.4百萬元、人民幣2,994.2百萬元、人民幣3,332.2百萬元及人民幣2,826.7百萬元，分別佔相同年度／期間總採購額的73.4%、58.2%、62.4%及65.6%。於往績記錄期間各年度／期間，我們從最大供應商的採購額分別為人民幣803.6百萬元、人民幣866.1百萬元、人民幣1,252.7百萬元及人民幣1,344.2百萬元，分別佔相同年度／期間總採購額的28.4%、16.8%、23.5%、31.2%。

競爭

我們在全球存儲產品行業經營，與多家國際及國內存儲產品製造商競爭。在AI、邊緣計算的擴張以及消費電子、汽車、工業及雲領域對高性能存儲解決方案不斷增長的需求的推動下，全球存儲產品市場由2020年的1,499億美元擴大到2024年的1,928億美元，複合年增長率為6.5%，預計到2029年將增長至4,071億美元。

根據弗若斯特沙利文的資料，我們是全球唯一一家具備晶圓級封裝能力的獨立存儲解決方案提供商。於2024年，按相關收入計，我們是全球最大的擁有自主封裝製造的獨立存儲製造商。同年，按相關收入計，我們亦為全球最大的AI新興端側半導體存儲解決方案供應商，在各類AI端側應用領域處於領先地位，包括AI/AR眼鏡、AI智能手錶及AI學習機。

歷史財務資料概要

下表呈列本文件附錄一會計師報告所載截至2022年、2023年、2024年12月31日止年度及截至2025年6月30日止六個月的合併損益及其他綜合收益表及合併現金流量表、截至2022年、2023年、2024年12月31日及2025年6月30日的合併財務狀況表的合併財務數據概要。以下數據及討論應與我們的合併財務報表及相關附註以及「財務資料」一節一併閱讀。

概 要

經營業績主要組成部分說明

下表載列我們於所示期間按絕對金額列示的經營業績概要：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	(人民幣千元)			(未經審計)	
收入	2,985,693	3,590,752	6,695,185	3,440,780	3,912,337
銷售成本	<u>(2,602,434)</u>	<u>(3,667,470)</u>	<u>(5,537,920)</u>	<u>(2,571,596)</u>	<u>(3,563,695)</u>
毛利／(毛損)	383,259	(76,718)	1,157,265	869,184	348,642
一般及行政開支	(75,739)	(152,760)	(292,938)	(149,267)	(175,742)
銷售及營銷開支	(98,978)	(162,477)	(253,826)	(117,909)	(130,506)
研發開支	(126,397)	(249,980)	(447,432)	(210,325)	(272,929)
金融資產減值虧損淨額	(6,160)	(1,839)	(4,959)	(1,687)	(4,442)
其他收入	13,770	13,985	36,082	16,454	14,591
其他(虧損)／收益，淨額	<u>(17,946)</u>	<u>(3,350)</u>	<u>110,491</u>	<u>6,669</u>	<u>(12,826)</u>
經營利潤／(虧損)	<u>71,809</u>	<u>(633,139)</u>	<u>304,683</u>	<u>413,119</u>	<u>(233,212)</u>
財務收入	<u>477</u>	<u>4,341</u>	<u>7,307</u>	<u>2,079</u>	<u>1,644</u>
財務成本	<u>(5,282)</u>	<u>(113,230)</u>	<u>(147,211)</u>	<u>(71,517)</u>	<u>(77,377)</u>
除所得稅前利潤／(虧損)	<u>67,004</u>	<u>(742,028)</u>	<u>164,779</u>	<u>343,681</u>	<u>(308,945)</u>
所得稅抵免／(開支)	<u>4,214</u>	<u>111,161</u>	<u>(29,535)</u>	<u>(70,801)</u>	<u>67,598</u>
年／期內利潤／(虧損)	<u>71,218</u>	<u>(630,867)</u>	<u>135,244</u>	<u>272,880</u>	<u>(241,347)</u>

概 要

非國際財務報告準則計量

為補充我們根據國際財務報告準則呈列的合併財務報表，我們亦採用非國際財務報告準則所規定或據此呈列的經調整淨利潤作為額外的財務指標。我們認為，該非國際財務報告準則計量可通過消除若干項目的潛在影響而有利於比較不同年度及不同公司的經營表現。我們認為，該計量為投資者及其他人士提供有用信息，使其與管理層採用相同的方式了解及評估我們的合併經營業績。然而，我們呈列的該非國際財務報告準則財務計量未必可與其他公司所呈列的類似指標直接可比。不應將此非國際財務報告準則計量視作我們根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的替代分析。

我們將年／期內經調整淨利潤或虧損（非國際財務報告準則計量）界定為通過加回股份支付費用而作出調整的年／期內淨利潤或虧損。我們將經調整EBITDA（非國際財務報告準則計量）界定為通過加回(i)折舊及攤銷，(ii)財務成本，及(iii)所得稅開支，再減去所得稅抵免而作出調整的年／期內經調整淨利潤或虧損（非國際財務報告準則計量）。下表為我們所呈列的年／期內經調整淨利潤或虧損與根據國際財務報告準則計算及呈列的最直接可比的財務指標（即年／期內淨利潤或虧損）的對賬：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	(人民幣千元)			(未經審計)	
年／期內淨利潤／(虧損) . . .	71,218	(630,867)	135,244	272,880	(241,347)
加：					
— 股份支付費用	7,051	130,870	338,054	197,402	150,225
年／期內經調整淨利潤／(虧損) (非國際財務報告準則計量)	78,269	(499,997)	473,298	470,282	(91,122)
加回：					
折舊及攤銷	49,296	68,790	115,564	48,619	71,912
財務成本	5,282	113,230	147,211	71,517	77,377
所得稅(抵免)／開支	(4,214)	(111,161)	29,535	70,801	(67,598)
經調整EBITDA(非國際財務報 告準則計量)	128,633	(429,138)	765,608	661,219	(9,431)

概 要

合併財務狀況表節選項目

下表載列截至所示日期我們的合併財務狀況表的節選資料：

	截至12月31日止年度			截至 6月30日 止六個月
	2022年 金額	2023年 金額	2024年 金額	2025年 金額
	(人民幣千元)			(未經審計)
非流動資產總值	887,875	1,451,951	2,273,442	3,235,658
流動資產總值	<u>3,523,325</u>	<u>4,880,448</u>	<u>5,687,514</u>	<u>8,320,166</u>
資產總值	<u>4,411,200</u>	<u>6,332,399</u>	<u>7,960,956</u>	<u>11,555,824</u>
非流動負債總額	387,354	512,833	956,498	1,962,929
流動負債總額	<u>1,602,289</u>	<u>3,898,444</u>	<u>4,573,691</u>	<u>5,381,192</u>
負債總額	<u>1,989,643</u>	<u>4,411,277</u>	<u>5,530,189</u>	<u>7,344,121</u>
流動資產淨值	<u>1,921,036</u>	<u>982,004</u>	<u>1,113,823</u>	<u>2,938,974</u>
本公司擁有人應佔權益	2,421,557	1,928,295	2,411,868	4,203,671
股本	430,329	430,329	431,240	461,266
儲備	1,848,448	1,979,545	2,300,974	4,288,546
非控股權益	<u>—</u>	<u>(7,173)</u>	<u>18,899</u>	<u>8,032</u>
權益總額	<u>2,421,557</u>	<u>1,921,122</u>	<u>2,430,767</u>	<u>4,211,703</u>

我們的淨資產(權益總額)由截至2022年12月31日的人民幣2,421.6百萬元減少至截至2023年12月31日的人民幣1,921.1百萬元，主要由於年內虧損人民幣630.9百萬元，部分被股份支付費用人民幣130.9百萬元所抵銷。我們的淨資產由截至2023年12月31日的人民幣1,921.1百萬元增加至截至2024年12月31日的人民幣2,430.8百萬元，主要由於(i)年內利潤人民幣135.2百萬元及(ii)股份支付費用人民幣338.1百萬元。我們的淨資產由截至2024年12月31日的人民幣2,430.8百萬元增加至截至2025年6月30日的人民幣4,211.7百萬元，主要由於發行股份人民幣1,870.7百萬元，部分被期內虧損人民幣241.3百萬元所抵銷。

我們的流動資產淨值由截至2022年12月31日的人民幣1,921.0百萬元減少48.9%至截至2023年12月31日的人民幣982.0百萬元，主要是由於(i)借款增加人民幣1,853.6百萬元，(ii)貿易應付款項及應付票據增加人民幣393.8百萬元，及(iii)現金及現金等價物減少人民幣557.9百萬元，部分被存貨增加人民幣1,598.1百萬元所抵銷。我們的流動資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣982.0百萬元增加13.4%至截至2024年12月31日的人民幣1,113.8百萬元，

概 要

主要是由於(i)貿易應收款項及應收票據增加人民幣201.5百萬元，及(ii)現金及現金等價物增加人民幣279.0百萬元，部分被借款增加所抵銷。我們的流動資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣1,113.8百萬元大幅增加至截至2025年6月30日的人民幣2,939.0百萬元，主要是由於(i)存貨增加人民幣845.0百萬元，(ii)貿易應收款項及應收票據增加人民幣397.9百萬元，及(iii)現金及現金等價物增加人民幣1,182.8百萬元，部分被貿易應付款項及應付票據增加人民幣602.3百萬元所抵銷。我們的流動資產淨值由截至2025年6月30日的人民幣2,939.0百萬元增加18.7%至截至2025年8月31日的人民幣3,489.3百萬元，主要是由於(i)存貨增加人民幣987.7百萬元，及(ii)現金及現金等價物增加人民幣121.4百萬元，部分被借款增加人民幣737.2百萬元所抵銷。

合併現金流量表概要

下表載列我們於所示期間的合併現金流量表的選定數據：

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
			(人民幣千元)		(未經審計)
經營活動(所用)／所得現金淨額	(692,591)	(1,789,081)	529,747	649,910	(700,563)
投資活動所用現金淨額	(281,518)	(453,883)	(1,011,645)	(247,401)	(1,027,412)
融資活動所得／(所用)現金淨額	1,492,798	1,681,179	744,855	(49,447)	2,935,150
年／期初現金及現金等價物	204,106	690,077	132,142	132,142	411,142
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(32,718)	3,850	16,043	9,364	(24,353)
年／期末現金及現金等價物	690,077	132,142	411,142	494,568	1,593,964

概 要

節選財務比率

下表載列我們於所示期間或截至所示日期的主要財務比率：

	截至12月31日／截至該日止年度			截至
	2022年	2023年	2024年	6月30日／ 截至該日止 六個月 2025年 (未經審計)
收入增長率(%)	不適用	20.3	86.5	13.7
毛利率／(毛損率)(%) ⁽¹⁾	12.8	(2.1)	17.3	8.9
流動比率 ⁽²⁾	2.2	1.3	1.2	1.5
經調整淨利潤率(%) (非國際 財務報告準則計量) ⁽³⁾	2.6	(13.9)	7.1	(2.3)
經調整EBITDA利潤率 ⁽⁴⁾ (非國 際財務報告準則計量)(%)	4.3	(12.0)	11.4	(0.2)

附註：

- (1) 毛利率等於毛利除以收入再乘以100%。
- (2) 流動比率等於同日的流動資產除以流動負債。
- (3) 經調整淨利潤率(非國際財務報告準則計量)按相關期間的經調整期內利潤(非國際財務報告準則計量)除以該期間收入再乘以100%計算。
- (4) 經調整EBITDA利潤率(非國際財務報告準則計量)按相關期間的經調整EBITDA(非國際財務報告準則計量)除以該期間收入再乘以100%計算。

風險因素

我們的業務及[編纂]涉及本文件「風險因素」一節所載的若干風險。閣下於決定投資我們的股份前，應仔細閱讀該節全文。我們面臨的一些主要風險包括：

- 我們所處的存儲產品行業競爭激烈，技術發展迅速。我們未能迎合不斷變化的市場趨勢、行業慣例及迅速的技術變革，可能會削弱我們的競爭力，並對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。
- 倘我們未能開發出獲市場接納的新解決方案，我們的競爭地位可能會受到影響。因此，我們的業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響。

概 要

- 晶圓及關鍵半導體設備等主要原材料的價格波動或供應中斷，可能會中斷我們的生產並影響我們的盈利能力。
- 我們產品的關鍵原材料供應高度集中於少數供應商，若與彼等的關係惡化，可能會嚴重影響我們的生產及業務營運。
- 下游消費需求下降及我們解決方案的終端市場發展較預期緩慢，可能會導致銷量減少、解決方案平均售價及利潤率下降，因而對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

申請於聯交所[編纂]

我們已向上市委員會申請批准根據[編纂]將予[編纂]的H股(包括因行使[編纂]而可能[編纂]的任何H股)[編纂]及[編纂]，基準為(其中包括)我們符合上市規則第8.05(3)條項下的市值／收益測試，並參考(i)我們截至2024年12月31日止年度的收益為人民幣6,695.2百萬元，高於上市規則第8.05(3)條規定的500百萬港元；及(ii)我們於[編纂]時的預期市值(按指示性[編纂]範圍的下限計算)超過上市規則第8.05(3)條規定的40億港元。H股預期將於[編纂]開始在聯交所買賣。除已在上海證券交易所科創板上市的A股及我們尚待聯交所批准H股[編纂]及[編纂]的申請外，截至最後實際可行日期，我們的股本或貸款資本概無於聯交所或任何其他證券交易所[編纂]或買賣，亦無尋求或擬尋求任何有關[編纂]或[編纂]許可。

我們的單一最大股東

截至最後實際可行日期，孫先生有權行使24.74%已發行股份總額(不包括庫存股)附帶的投票權，包括(i)孫先生直接持有的17.65%已發行股份總額(不包括庫存股)附帶的投票權；及(ii)第一份一致行動協議訂約方及第二份一致行動協議訂約方通過一致行動協議直接持有的7.09%已發行股份總額(不包括庫存股)附帶的投票權。一致行動協議將於2025年12月30日到期。據本公司所知及所信，截至最後實際可行日期，第一份一致行動協議訂約方及第二份一致行動協議訂約方目前並無續簽一致行動協議的意向。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，一致行動協議已屆滿，且已發行股份及本公司股票回購賬戶持有的已購回A股數目並無其他變動)，孫先生將有權行使我們總計已發行股份(不包括庫存股)[編纂]%所附帶的投票權。因此，孫先生於[編纂]後將繼續作為我們的單

概 要

一最大股東。有關孫先生及一致行動協議的進一步資料，請參閱「董事及高級管理層」及「歷史、發展及公司架構 — 我們的單一最大股東」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]所述範圍的中位數)，我們估計我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]百萬港元(經扣除[編纂]佣金及有關[編纂]的其他估計開支)。

我們擬將預期從[編纂]收取[編纂]淨額按以下載列用途及金額使用：

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於提升我們的研發能力並推動產品創新，以滿足不斷變化的市場需求以及AI應用日益提高的技術要求。
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於全球擴張戰略，提升我們於海外市場的影響力。
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於潛在戰略投資、合作以及併購機會。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於營運資金及一般企業用途。

近期發展及無重大不利變化

我們自2025年6月30日以來一直保持穩定的業務運營與發展。董事已確認，截至本文件日期，自2025年6月30日(即合併財務報表的最近結算日)以來，我們的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動，且自2025年6月30日以來，概無發生會對本文件附錄一所載會計師報告所示資料造成重大影響的事件。

概 要

[編纂]統計數據

下表統計數據均基於以下假設：(i)[編纂]已完成且根據[編纂][編纂][編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)緊隨[編纂]完成後有[編纂]股[編纂]及尚未行使股份。

	基於[編纂]每股H 股[編纂]港元	基於[編纂]每股H 股[編纂]港元
H股市值 ⁽¹⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
股份市值 ⁽²⁾	[編纂]港元	[編纂]港元
截至2025年6月30日未經審計[編纂]經調整合 併每股有形資產淨值 ⁽³⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) H股市值乃根據緊隨[編纂]完成後預期[編纂]的[編纂]股H股計算(假設[編纂]未獲行使)。
- (2) 股份市值乃根據緊隨[編纂]完成後預期已發行的[編纂]股H股及466,708,301股A股計算(假設[編纂]未獲行使)。A股市值根據緊接最後實際可行日期前五個營業日A股平均收市價每股A股人民幣105.93元及截至最後實際可行日期已發行的466,708,301股A股計算。
- (3) 未經審計[編纂]經調整合併每股有形資產淨值乃經作出本文件「附錄二 — 未經審計[編纂]財務資料」所述的調整後計算。

股息及股息政策

於往績記錄期間，本公司或本集團旗下其他實體並無派付或宣派任何其他股息。任何股息的宣派及派付以及股息金額將受我們的組織章程細則及相關中國法律規限。我們目前並無任何固定的股息派付比率。除非自我們依法可供分派的利潤及儲備中撥付，否則不得宣派或派付股息。據我們的中國法律顧問確認，根據相關中國法律，我們未來產生的任何淨利潤將須首先應用於彌補我們過往的累計虧損，之後我們須將我們淨利潤的10%分配至我們的法定公積金，直至有關公積金已達到我們註冊資本的50%以上。因此，我們將僅能於：(i)已彌補我們所有過往的累計虧損；及(ii)我們已將足夠的淨利潤分配至上述法定公積金後方可宣派股息。

概 要

[編纂]開支

[編纂]開支指就[編纂]產生的專業費用、[編纂]佣金及其他費用。我們估計[編纂]開支將約為[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)且[編纂]未獲行使)，佔[編纂][編纂]總額的[編纂]%(基於[編纂]的指示性價格範圍的中位數並假設[編纂]未獲行使)。我們估計[編纂]開支包括約[編纂]港元的[編纂]費用及[編纂]港元的非[編纂]費用(包括法律顧問及申報會計師的費用及開支約[編纂]港元以及其他費用及開支約[編纂]港元)。在[編纂]開支總額中，約[編纂]港元將直接歸屬於[編纂]股份，將於[編纂]完成後自權益中扣除，而餘下約[編纂]港元將於合併綜合收益表支出。